

Ensinger per la tecnologia MID

Compound speciali per il progetto UE sui dispositivi di interconnessione stampati (MID)

La produzione di dispositivi di interconnessione stampati (MID) comporta la diretta integrazione di conduttori all'interno di componenti plastici tridimensionali che possono essere modellati in qualsiasi forma scelta. Con un tasso di crescita annuo del 20 per cento, la tecnologia MID rappresenta uno dei mercati del futuro. In qualità di specialista nel settore dei materiali plastici ad alte prestazioni, Ensinger è parte di un consorzio di aziende ed istituti internazionali che operano nell'ambito del progetto 3D-HiPMAS sostenuto dall'Unione Europea per guidare il progresso tecnologico in questo ambito.

L'integrazione dei conduttori permette la miniaturizzazione dei componenti, un risparmio tangibile di peso e la riduzione dei costi grazie alle semplificate operazioni di assemblaggio ed alle nuove funzionalità. Le basi per i dispositivi interconnessi stampati sono i polimeri termoplastici per alte temperature con speciali proprietà. I conduttori sono applicati mediante una strutturazione laser diretta (LDS) e metallizzazione. Ensinger ha modificato i compound termoplastici della sua linea di prodotti TECACOMP LDS specificamente per i processi di produzione utilizzati nella realizzazione dei componenti MID.

Con l'obiettivo di miniaturizzare ulteriormente i componenti elettronici, i partner del progetto europeo stanno sviluppando quattro linee dimostrative per applicazioni nel campo delle energie alternative, tecnologia elettronica, mobilità e medicina. Importanti attività in questi settori includono la riduzione della larghezza dei conduttori ed il miglioramento della dilatazione termica e della conduzione.



Didascalia:

L'uso di materiali termoplastici per alte temperature e la loro metallizzazione strutturata apre a una nuova dimensione di dispositivi di interconnessione per l'industria elettronica. I dispositivi di interconnessione stampati (MID) sono articoli stampati con una struttura conduttrice integrata che apre enormi potenzialità tecniche di razionalizzazione e sono molto più rispettosi dell'ambiente rispetto ai convenzionali pcb.

Immagine: LPKF Laser & Electronics AG



Didascalia:

Ulteriori informazioni sul progetto Europeo all'indirizzo www.3d-mid.de/2/home/home.html

Su Ensinger

Ensinger Italia Srl, filiale italiana di Ensinger GmbH fondata nel 1966, fornisce materiali ad elevate prestazioni sotto forma di semilavorati estrusi e colati, nonché pezzi finiti in materiale plastico adatti alle diverse esigenze applicative. Ensinger Italia dispone di uno dei più vasti e forniti magazzini di semilavorati in barra tonda, barra forata e lastre con servizio immediato di taglio, piallatura e rettifica ed è in grado di garantire la consegna entro 48h dall'ordine.

I prodotti Ensinger possono essere utilizzati in presenza di alte sollecitazioni meccaniche, sostanze chimiche aggressive, sterilizzazioni, garantiscono stabilità dimensionale, e possono essere conformi alle normative FDA – Reg. UE 10/2011 – ISO 10993 – ROHS. Sono quindi adatti per applicazioni in ambito aerospaziale, meccanico, elettronico, petrolchimico, alimentare, medicale, packaging e molti altri ancora .

La gamma Ensinger dei prodotti TECA®: TECALIT, TECAFINE, TECAMID, TECAST, TECAFORM, TECAPET, TECASON, TECAFLON, TECAPEEK, TECASINT. www.ensinger.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Ensinger Italia Srl: tel: +39.0331.568348 | e-mail: home@ensinger.it

Ufficio stampa Ensinger: Paola Taboga | tel: +39.02.26225795 | e-mail: taboga@enter.it